



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

臻鼎科技控股 (4958 TT)

投資人簡報

2023年10月30日

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



## 全球第1大

### 印刷電路板製造公司

**2006年** 成立  
(前身華虹電子 1978)

**台灣桃園** 總部

**42,425**  
2022年平均員工數



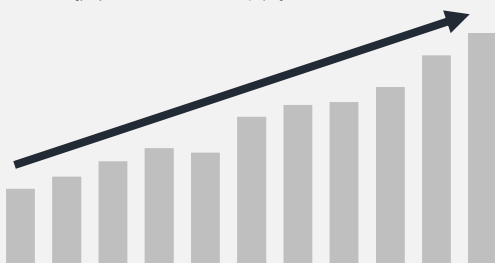
**22** 座工廠  
位於大陸、台灣、印度

**NT\$1,714億**

2022年營收(+10.5% YoY)

**+12%**

2012-2022年  
營收年複合成長率



**1,603**

累計有效獲證專利件數

**3,445**

累計專利申請  
(截至2023年9月底)



**NT\$932億**

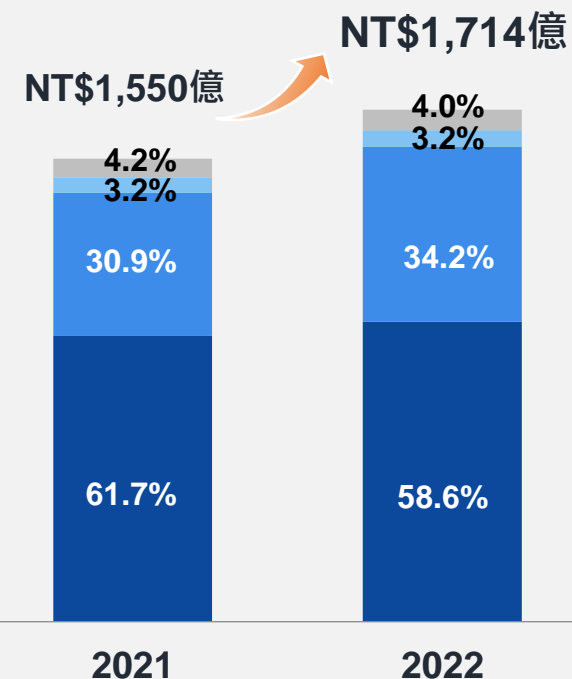
2023年9月底市值

**16.4%**

10年平均股東權益報酬率

銷售分析 – 產品應用別

**+10.5% YoY**



- 汽車雷達/基地台/伺服器及其他
- IC載板
- 電腦消費
- 行動通訊

## 為何投資臻鼎？

1

### 全球第一大PCB廠，長期穩健成長：

臻鼎自2017年起，榮登全球第一大PCB廠，2012-2022年營收年複合成長率達12%。

2

### 發揮One ZDT綜效，持續拉開領先差距：

以One ZDT為核心策略，發揮一站購足綜效，持續追求穩健成長。臻鼎2022年全球PCB市佔率為7.0%，目標2030年提升至10%。

3

### 積極拓展IC載板業務：

臻鼎規劃於2022-2027年投資新台幣600億元資本支出於IC載板，目標2030年成為全球前五大IC載板供應商。

4

### 全球化生產基地：

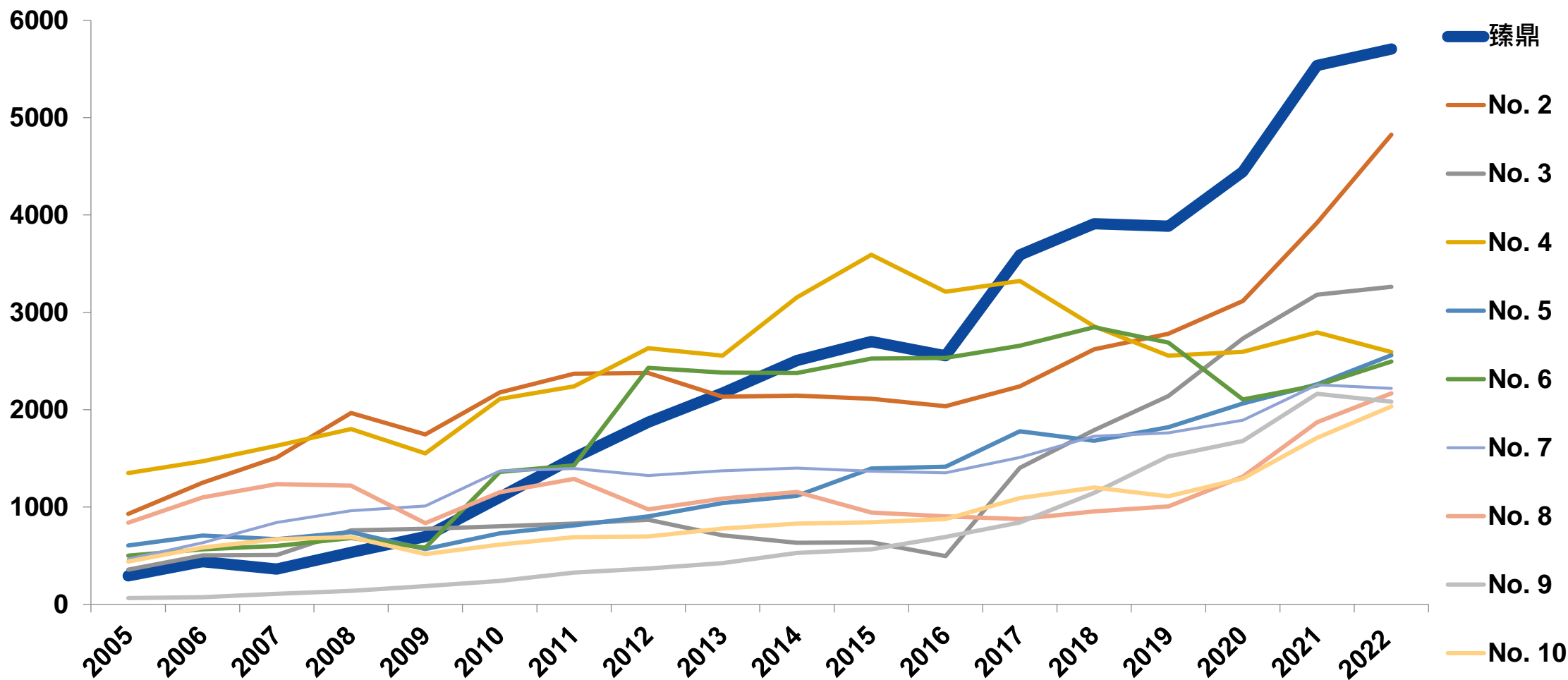
除大陸三座主要生產基地，臻鼎在台灣、印度亦設有廠區，並計畫於泰國設立新廠，未來將持續拓展全球化生產基地，服務多元客戶需求。

全球第一大PCB廠，長期穩健成長

---

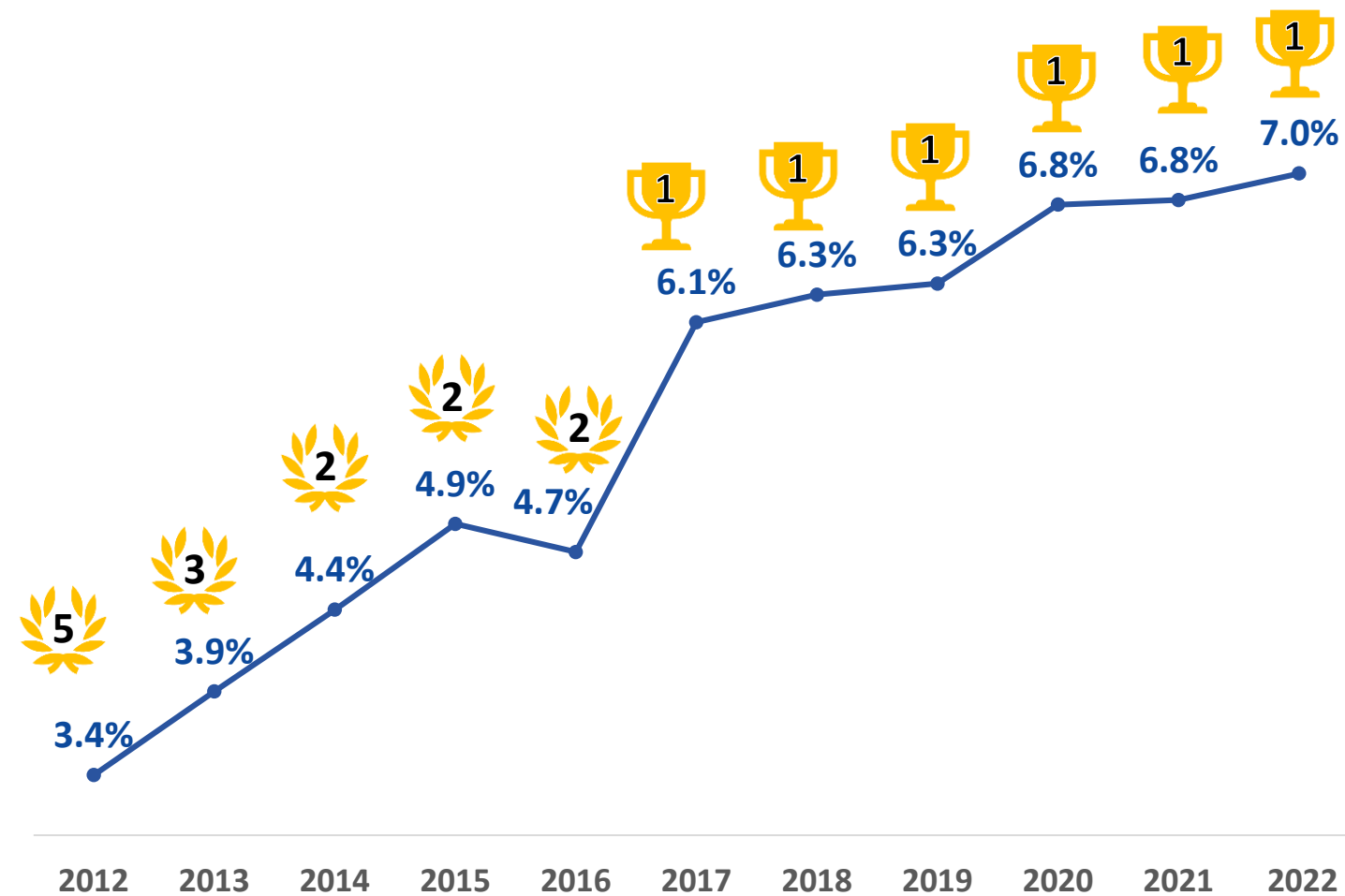
## 2022全球前十大PCB領導廠商歷年營收趨勢

單位：百萬美元



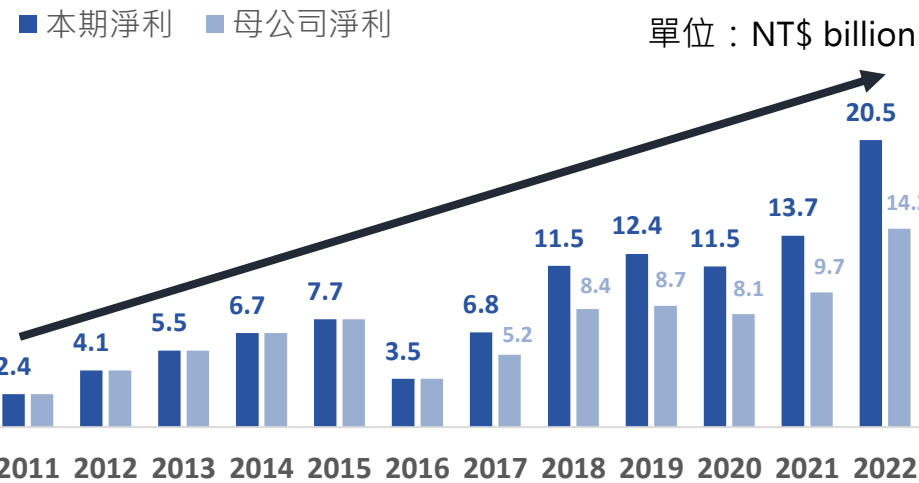
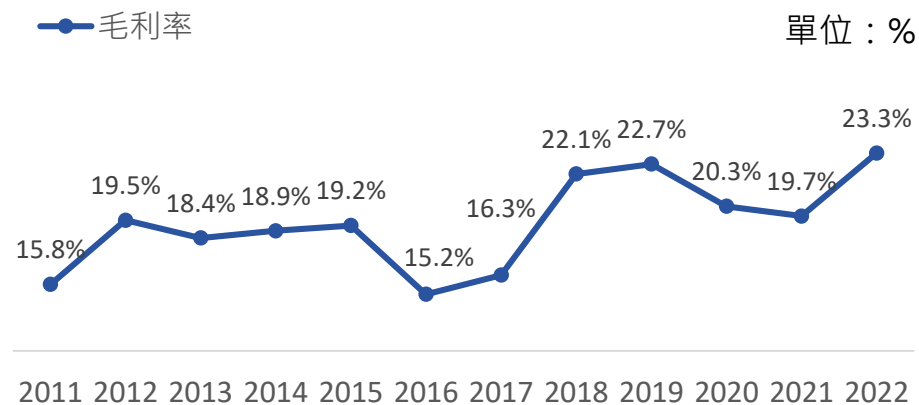
資料來源：NT Information；Prismark (2023/09)

**臻鼎持續提升全球PCB市占率**



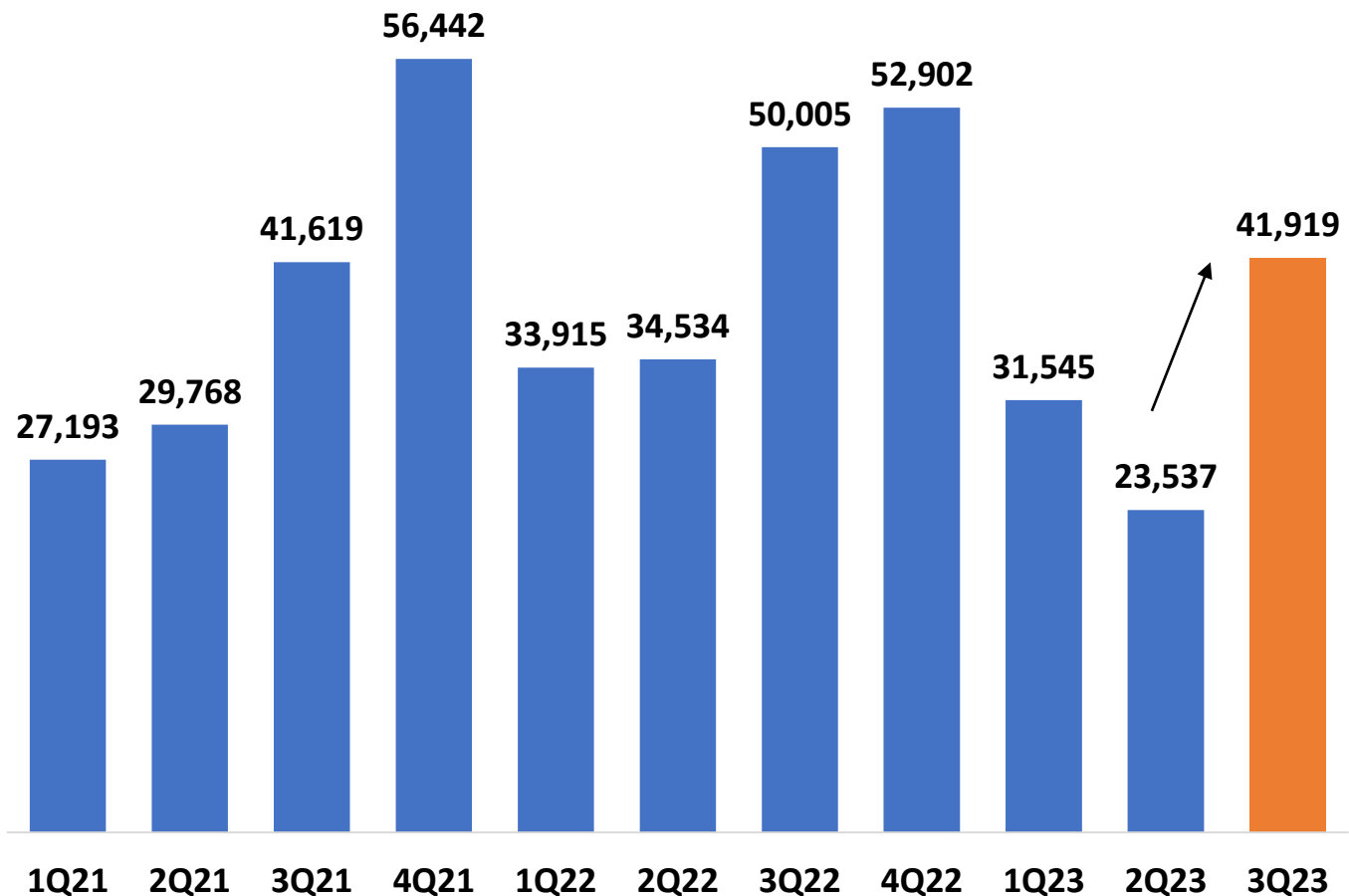
資料來源：Prismark

**同時保持穩健獲利**



## 臻鼎季度營收

單位：新台幣佰萬元



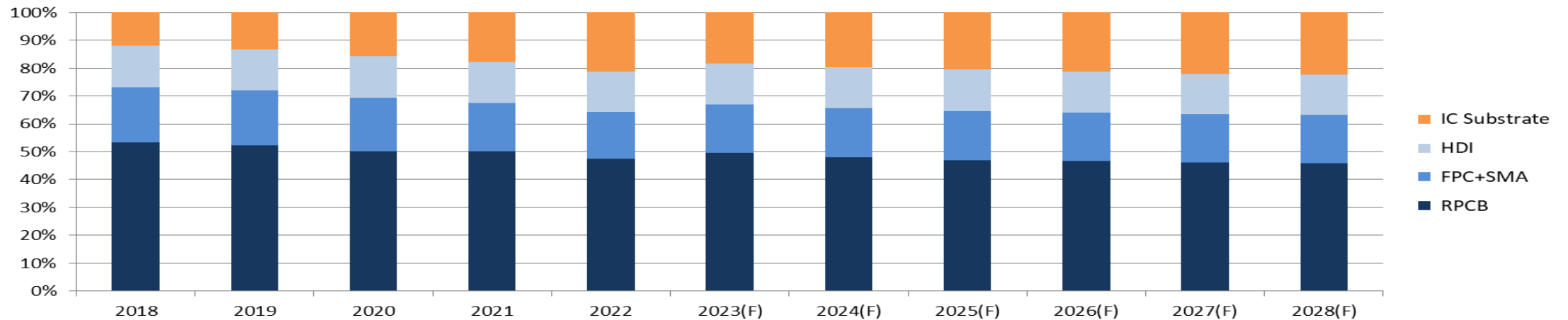
- **1H23營運面臨逆風，專注產品開發與營運效率優化：**受到消費性電子需求不振，及客戶新舊產品轉換期影響，臻鼎營收隨產業趨勢呈現年減。然而於此期間，公司專注產品開發與營運效率優化，具體效益包含行動通訊產品毛利率在上半年不景氣之中仍實現年增。
- **2H23預期將溫和復甦：**在客戶新品備貨挹注下，3Q23行動通訊與電腦消費營收季增超過八成，同時IC載板及汽車/基地台/伺服器營收亦雙位數季增，整體產能利用率維持高檔，下半年公司營運將溫和復甦。



發揮One ZDT綜效，持續拉開領先差距

目標2030年全球PCB市佔率達10%

# 各類PCB市場規模預期明年重回成長軌道



單位：百萬美元

產品	項目	2018	2019	2020	2021	2022	2023(F)	2024(F)	2025(F)	2026(F)	2027(F)	2028(F)	2023-2028 CAGR
RPCB	產值	33,225	31,969	32,674	40,641	38,720	34,542	34,986	36,576	39,025	41,768	42,486	4.20%
	佔全球比	53.20%	52.10%	50.10%	50.20%	47.40%	49.69%	47.98%	47.04%	46.61%	46.23%	45.97%	
FPC+SMA	產值	12,395	12,195	12,483	14,058	13,842	12,032	12,813	13,644	14,530	15,473	15,860	5.70%
	佔全球比	19.90%	19.90%	19.10%	17.40%	16.90%	17.31%	17.57%	17.55%	17.35%	17.13%	17.16%	
HDI	產值	9,222	9,008	9,874	11,811	11,763	10,131	10,795	11,503	12,257	13,061	13,361	5.70%
	佔全球比	14.80%	14.70%	15.10%	14.60%	14.40%	14.57%	14.80%	14.80%	14.64%	14.46%	14.46%	
IC Substrate	產值	7,554	8,139	10,188	14,410	17,415	12,809	14,327	16,024	17,923	20,046	20,720	10.10%
	佔全球比	12.10%	13.30%	15.60%	17.80%	21.30%	18.43%	19.65%	20.61%	21.40%	22.19%	22.42%	
合計		62,396	61,311	65,219	80,920	81,740	69,514	72,921	77,747	83,735	90,348	92,427	5.90%
年增率		6.04%	-1.74%	6.37%	24.07%	1.01%	-14.96%	4.90%	6.62%	7.70%	7.90%	2.30%	

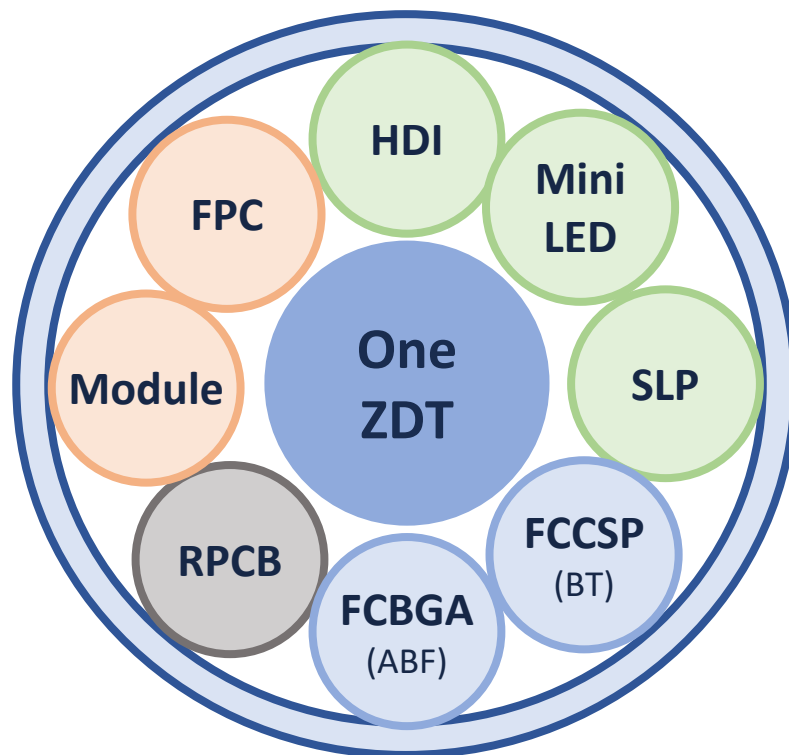
資料來源：Prismark (2023/10) 資料推估。

## FPC (+Module)

- 5G終端
- AR/VR元宇宙
- 新能源
- 智能車用
- 次世代顯示屏

## RPCB(+基站+汽車板+伺服器)

- 高速運算
- 5G基站
- 次世代雷達板
- 智能車用
- 高階Server & AI



## HDI(+SLP+Mini LED)

- HDI高階化、SLP化
- NB、車載HDI化
- 5G AiP、SiP
- AR/VR元宇宙
- Mini LED/Micro LED

## IC載板(FCCSP+FCBGA)

- 5G晶片
- 雲端高速運算
- Server & AI
- AR/VR元宇宙
- 智能車用

供應鏈管理日趨複雜，客戶注重的是供應鏈的易整合性，不再是精細分工尋求最低成本。

## 持續發揮One ZDT綜效

### 產品面

跨產品線布局多元應用，與客戶共同開發，提供產品最佳解決方案。

### 製造面

多廠區生產基地，因應客戶需求，靈活彈性調度產能。

### 管理面

各廠區分階段導入智能管理，互相學習優化生產效率與良率。

### 人才面

完善的人才培訓及升遷機制。部份優秀人才調派至新單位做為種子幹部。

## 協同客戶共同開發新應用市場

自動駕駛系統



雲端資料中心



低軌衛星



元宇宙



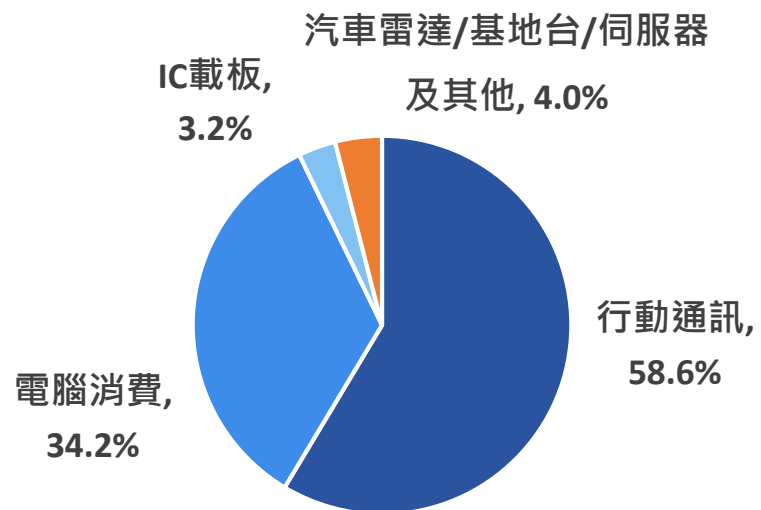


- 基於目前已量產客戶及開發中客戶，臻鼎目標未來五年伺服器應用營收年複合成長率達**雙位數**
- 成長策略：
  - 擴大現有客戶份額
  - 因應China+1客戶需求，同步認證淮安廠與先豐廠，儲備後續技轉泰國廠
  - 逐步將產品升級由 Server 跨入 Storage/Switch，並開發GPU 高階產品

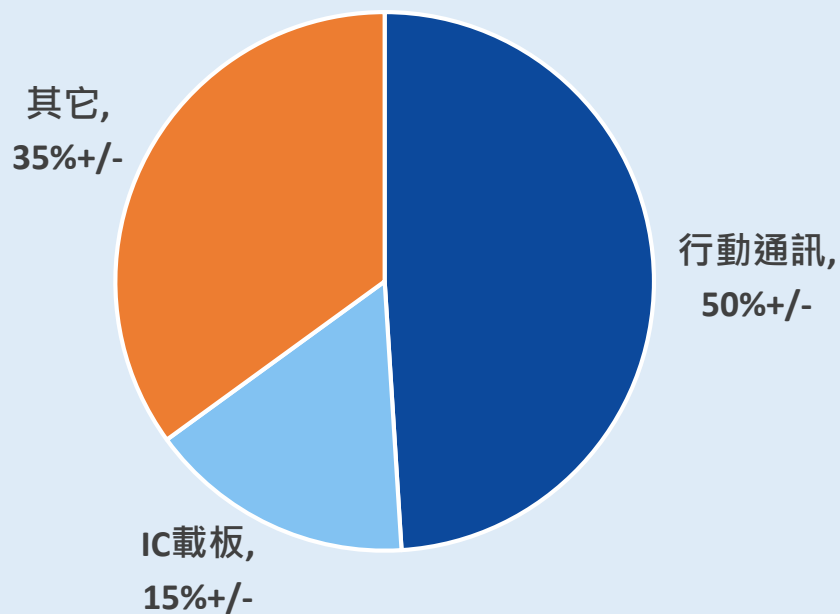


- 汽車朝自駕化、互聯化、電器化前提下，臻鼎高階量產經驗基礎上，臻鼎未來五年車載板應用年複合成長率達**雙位數**
- 成長策略
  - 開發ADAS高階應用雷達板
  - 高階自駕網域控制板
  - 擴大現有客戶EV車動力電池軟板份額
  - 增加東南亞泰國廠客戶與產能布局

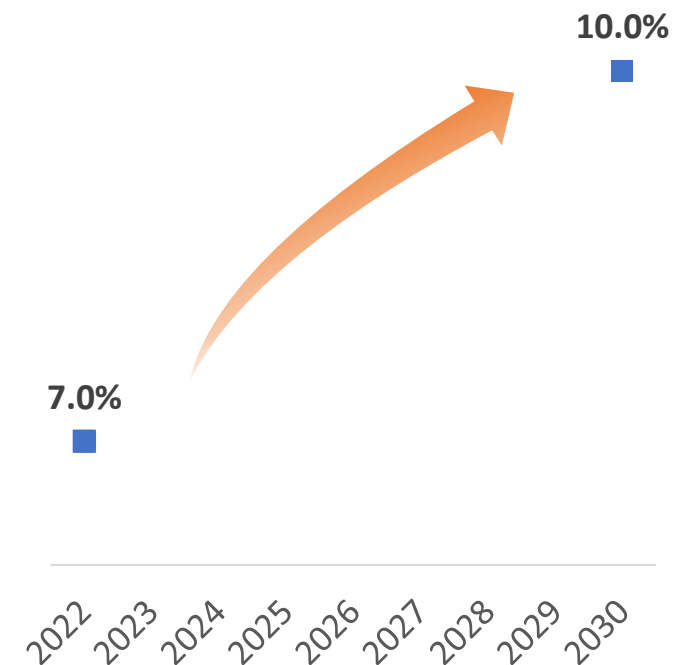
## 2022年營收產品應用比重



## 2027年目標營收產品應用比重



## 2030年目標全球市佔率達10%



# 積極拓展IC載板業務

目標2030年成為全球前五大

1

**多數BT載板客戶庫存已回到約略正常水位，ABF載板可望在年底觸底回升：**

- BT載板客戶庫存天數下降，多數已回到約略正常水位，且公司在耕耘記憶體重要客戶有所斬獲，正向看待BT業務回溫。
- ABF市場在部份應用上仍銷售暢旺，例如: AI、HPC等，整體應在年底有望觸底回升。

2

**反映產業供需情形，IC載板產業發展將較原先預期遞延1.5年：**

- 整個半導體產業中長期依舊看好，領先廠商如台積電及英特爾，仍持續擴廠。
- IC載板方面，中低階產品新進供應商多，且產能多集中於中國大陸，缺乏國際客戶開拓能力及經驗；中高階產品短期雖有波動，中長期仍有望供不應求。

3

**陸續通過國際客戶認證：**

- 半導體產業多為國際型客戶，公司陸續取得國際客戶認證，舉凡美系、歐系、日系及陸系客戶皆有佈局，客戶對公司智能化新廠高度認可。

4

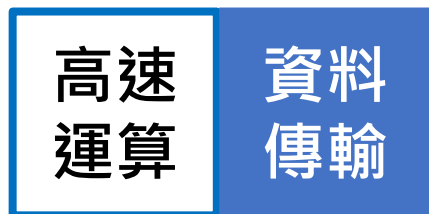
**聚焦持續開發高密度、細線路產品：**

- ABF載板方面，已開始與客戶開發Chiplet使用之高階載板。現出貨18~20層單顆最大尺寸92mm x 92mm產品，僅6個月良率已提升至ABF載板tier 1 供應商水準。未來將進階至20L以上，單顆尺寸100mm x 100mm以上。
- BT載板方面，佈局ETS細線路6/8um，亦為業界tier 1領先水準。



# AI應用-Chiplet 小晶片載板

## AI

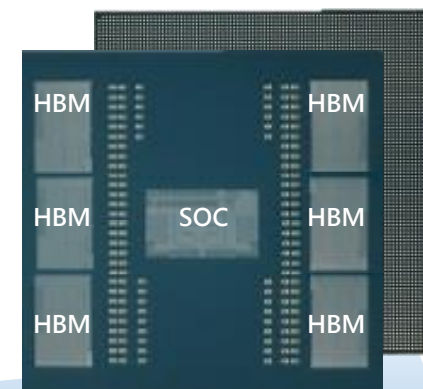


AI應用除需高速運算功能，  
還需搭配快速讀寫記憶體空間

## 晶片解決方案



## 小晶片載板



### 載板需求技術

高層數	大尺寸	微孔	細線路	銅面處理技術
✓ 18~20層	✓ 90x90 ~ 95x95mm	✓ 40 ~ 60 um	✓ 9~15 um	✓ 低粗糙度，高結合力

臻鼎  
IC載板

## 智能化



### 網域控制站

- 智駕網域控制站
- 座艙網域控制站

### 感測器

- 毫米波雷達
- 雷射雷達
- 攝像頭

## 使用晶片

自動駕駛AI晶片    影像感測器  
智慧座艙晶片    存儲晶片  
網域控制站DCU晶片    ADAS運算晶片

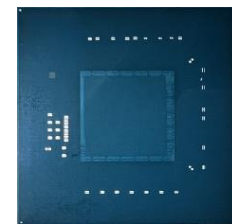


## 封裝方式

FCBGA  
CSP

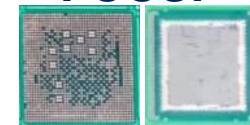
## ZDT載板

### FCBGA



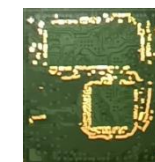
4~18L  
17x17~75x75mm

### FCCSP



2~4L  
7x7~27x27mm

### WBCSP



2~4L  
7x7~27x27mm

## 互聯化



### 通信模組

- 遠端通訊盒

### 車聯網

- 5G 模組

智慧座艙晶片



CSP

## 信息化



### 顯示系統

- HUD抬頭顯示
- AR/VR虛擬增強現實
- NFC近場通信

智慧座艙晶片  
存儲晶片



FCBGA  
CSP

# 四大新廠區為未來成長動能



秦皇島BT載板工廠：FC-CSP/WB-CSP/Memory



深圳 ABF載板工廠：FCBGA



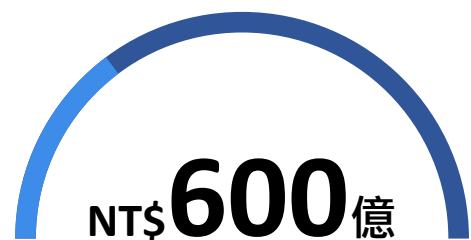
高雄路竹科學園區：軟板與先進模組的生產線



淮安第三園區：高階 HDI/MSAP

# IC載板產能規劃

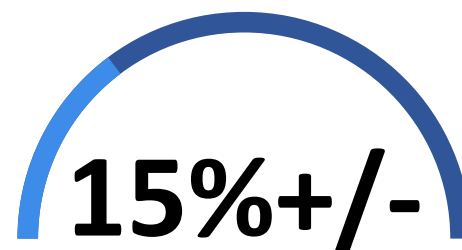
		2023				2024				2025				2026			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
<b>深圳 ABF載板</b> (兩廠樓地 板面積共17 萬平米)	<b>Fab 1</b> (中高階產品)	裝機															
		樣品認證															
		量產，目標良率與tier 1競爭對手相當								產能滿載， 目標良率與tier 1競爭對手相當							
<b>Fab 2</b> (高階產品)										裝機							
										樣品認證							
														量產			
<b>秦皇島 BT載板</b> (兩廠樓地 板面積共6 萬平米)	<b>Fab 1</b>	品質領先業界															
	<b>Fab 2</b>	量產				產能利用率60%+				產能利用 率80%+							



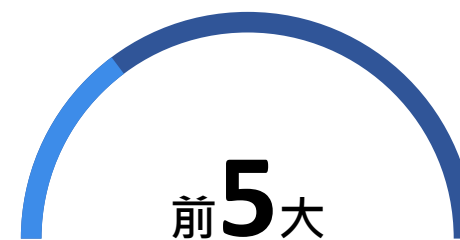
IC載板資本支出：  
2022-2027規劃投資600億



IC載板營收：  
2023-2027複合成長率 >50%



IC載板營收：  
至2027年，IC載板占臻鼎合併營收15%+/-



IC載板市占率：  
目標2030年成為IC載板全球前五大

# 全球化生產基地

---

多廠區生產基地，貼近客戶需求

## 中國大陸 秦皇島



秦皇島園區  
(FPC與先進模組  
/SLP高階 HDI)



BT載板園區  
(第一期2022年量產)

## 中國大陸 淮安



淮安第一園區  
(RPCB/HDI)



淮安第二園區  
(FPC與先進模組  
/HDI/Mini LED 背  
光超薄細線路電路板)



淮安第三園區  
(高階 HDI/MSAP)  
(2023年量產)

## 印度



清奈園區  
(FPC先進模組)

## 中國大陸 深圳



深圳第一園區  
(FPC與先進模組/HDI)



深圳第二園區  
(FPC先進模組)



ABF載板園區  
(第一期2023年量產)

## 台灣



高雄園區  
(FPC與先進模組)  
(預計2024年量產)



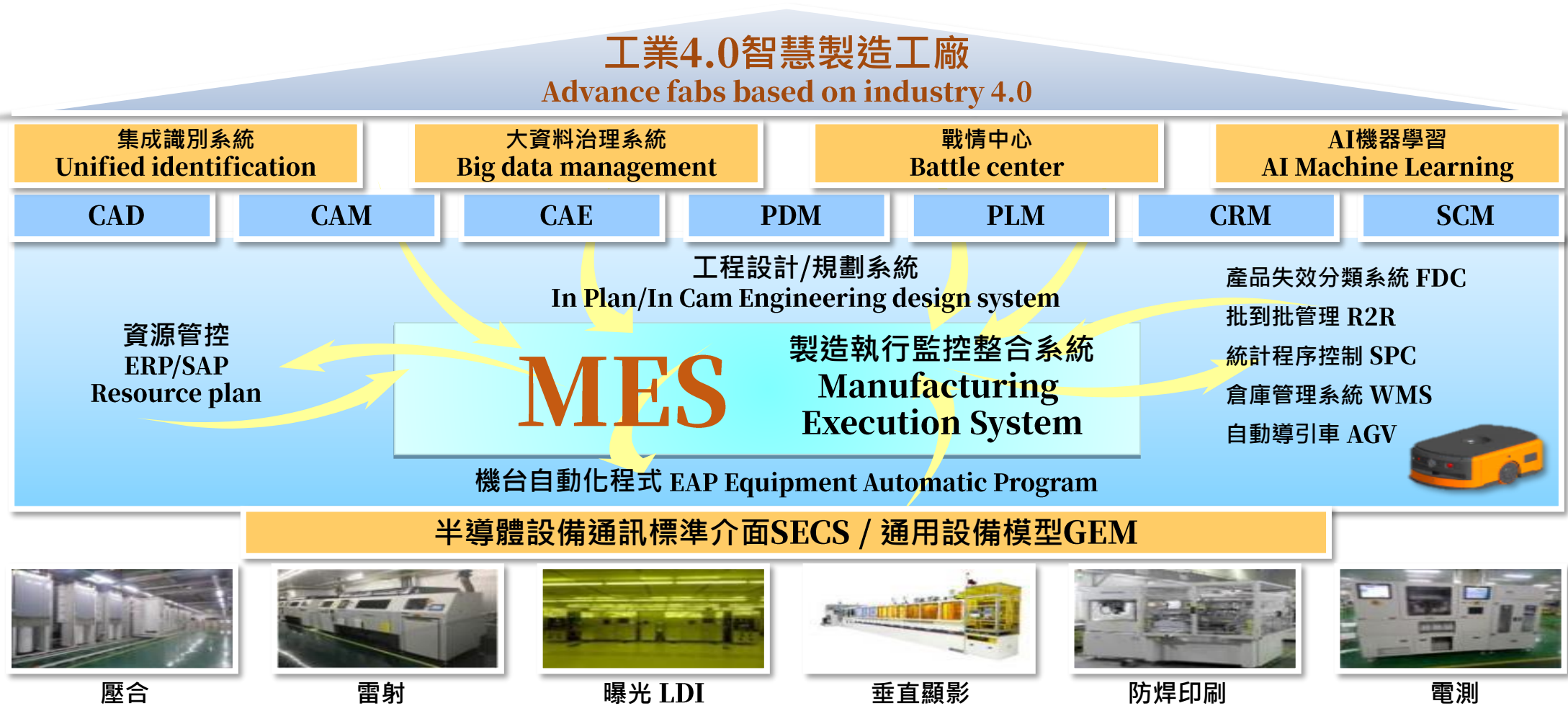
桃園 先豐通訊園區  
(網通、高速運算、汽車  
等相關領域之印刷電路板)



## 與當地夥伴策略合作

- 因應客戶需求，完善公司全球化布局戰略。
- 擬選址泰國巴真府。
- 預計2023年12月12日舉行動土典禮，第一期投資金額2.5億美金。
- 預計2025年上半年試生產。





在One ZDT 策略下，各廠區分階段導入智能管理，目前淮安第三園區新廠已是導入智能管理的第九座工廠，在良率及效率上都有顯著的效益。



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

致力推動EPS + ESG

---

## ESG評鑑結果

### ▶ 臺灣公司治理評鑑

2023年公司治理評鑑排名上市公司**6%-20%**，再度入選**臺灣證券交易所公司治理100指數**。

### ▶ 晨星Sustainalytics ESG 風險評級

2023年Sustainalytics ESG風險評級由**17.8**進步至**15.6**，為**低等級風險等級**。

### ▶ 標普全球企業永續評鑑 S&P Global ESG

2022年S&P Global ESG 評級進步至**71分**，入選**標普全球永續年鑑 (Sustainability Yearbook)**。

### ▶ 富時羅素 FTSE Russell ESG

2022年12月FTSE Russell ESG評級由**3.6分**進步至**4.3分** (滿分為**5分**)，成為**台灣上市櫃公司並列第三名**。

## ESG亮點績效

### ▶ 溫室氣體排放與能源管理

2022年單位營收溫室氣體排放 ( 範疇一及範疇二 ) 較2013年**減少35%**。

2022年再生能源使用量較前一年**增加16倍**。

### ▶ 水資源管理

2022年單位營收用水量較2013年**減少40%**。

2022年廢水回用率達**50.5%**。

### ▶ 循環經濟與綠色採購

積極與供應商與客戶共同推動回收金屬的使用。回收錫膏之使用率達**90%**，金鹽的回收數量已達金鹽使用量的**42%**。

### ▶ 董事會結構

2023年董事改選後，獨立董事佔比達**57%**，女性董事佔比**14%**。



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding



# 2023年上半年營運成果

---

**1** 總體環境不佳、終端需求疲弱，導致產業產能過剩，面臨客戶降價壓力，在價量同時承壓下，致使上半年營收年減 **19.5%**。

**2** 公司看好未來產業趨勢，包含IC載板領域，持續投入研發與資本支出，上半年

- 研發費用 42.4億，較去年同期增加 7.4億，增長21%。
- 資本支出 147億，和去年同期約當。
- 折舊攤銷 80億，較去年同期增加 10.5億，增長15%。

**3** 公司財務穩健(截至2023年6月30日)

- 淨現金水位 125億，較去年同期增加 70億。
- 負債比率 43.9%，和去年同期約當。

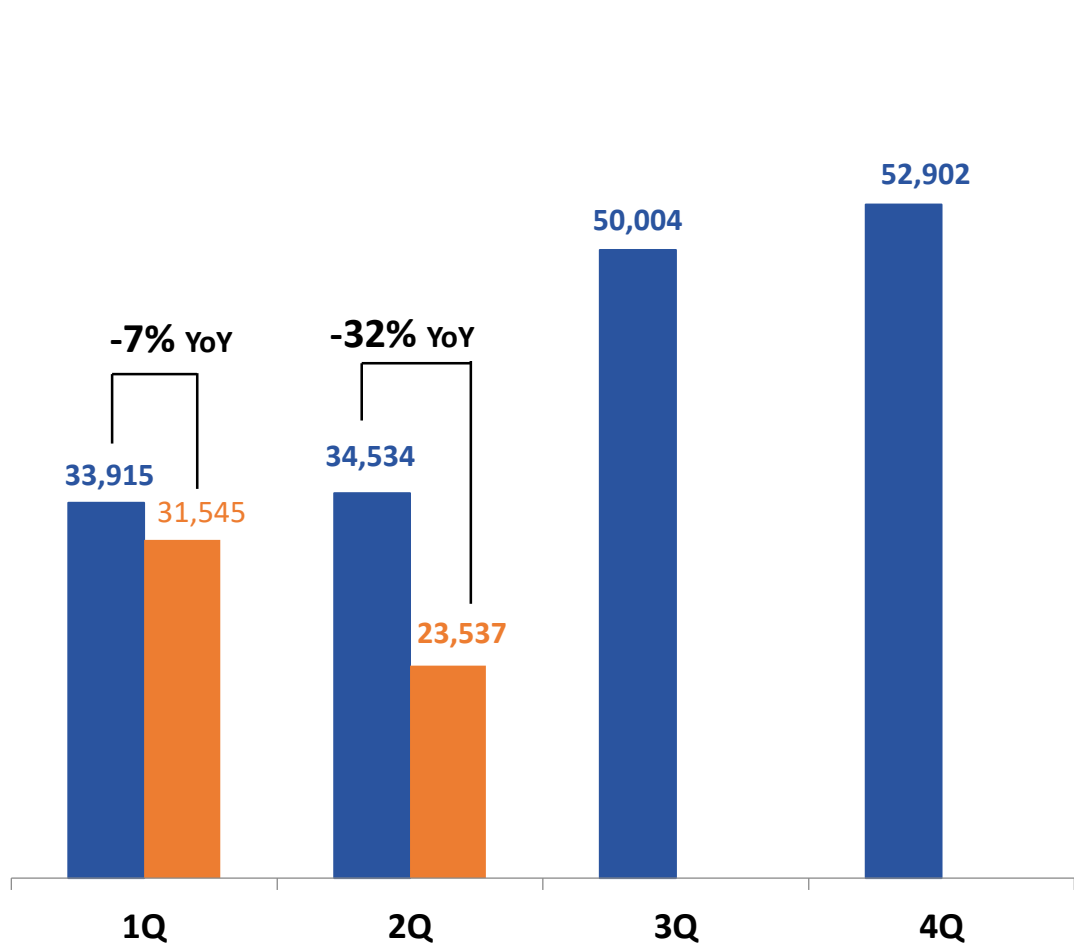
單位: 新台幣佰萬元, 除另予註明者外

	1H23	1H22	年變化 (%)
營業收入	55,082	68,450	-19.5%
營業毛利	7,198	12,990	-44.6%
<b>營業毛利率</b>	<b>13.1%</b>	<b>19.0%</b>	<b>-5.9ppts</b>
營業費用	7,867	7,303	+7.7%
營業利益	(669)	5,686	
<b>營業利益率</b>	<b>-1.2%</b>	<b>8.3%</b>	<b>-9.5ppts</b>
營業外收入及支出	1,075	1,651	-34.9%
本期淨利	1,013	6,506	-84.4%
<b>淨利率</b>	<b>1.8%</b>	<b>9.5%</b>	<b>-7.7ppts</b>
歸屬於母公司之淨利	414	4,507	-90.8%
每股盈餘 (新台幣元) <sup>(1)</sup>	<b>0.44</b>	<b>4.77</b>	
營運活動之現金流入	15,216	21,443	-29.0%
資本支出	14,684	15,246	-3.7%
現金及約當現金 <sup>(2)</sup>	59,916	44,480	+34.7%
股東權益報酬率 (%) <sup>(3)</sup>	1.6%	11.2%	-9.6ppts

附註：(1) 2023年上半年加權平均流通在外股數為944,956仟股。(2)現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。  
(3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

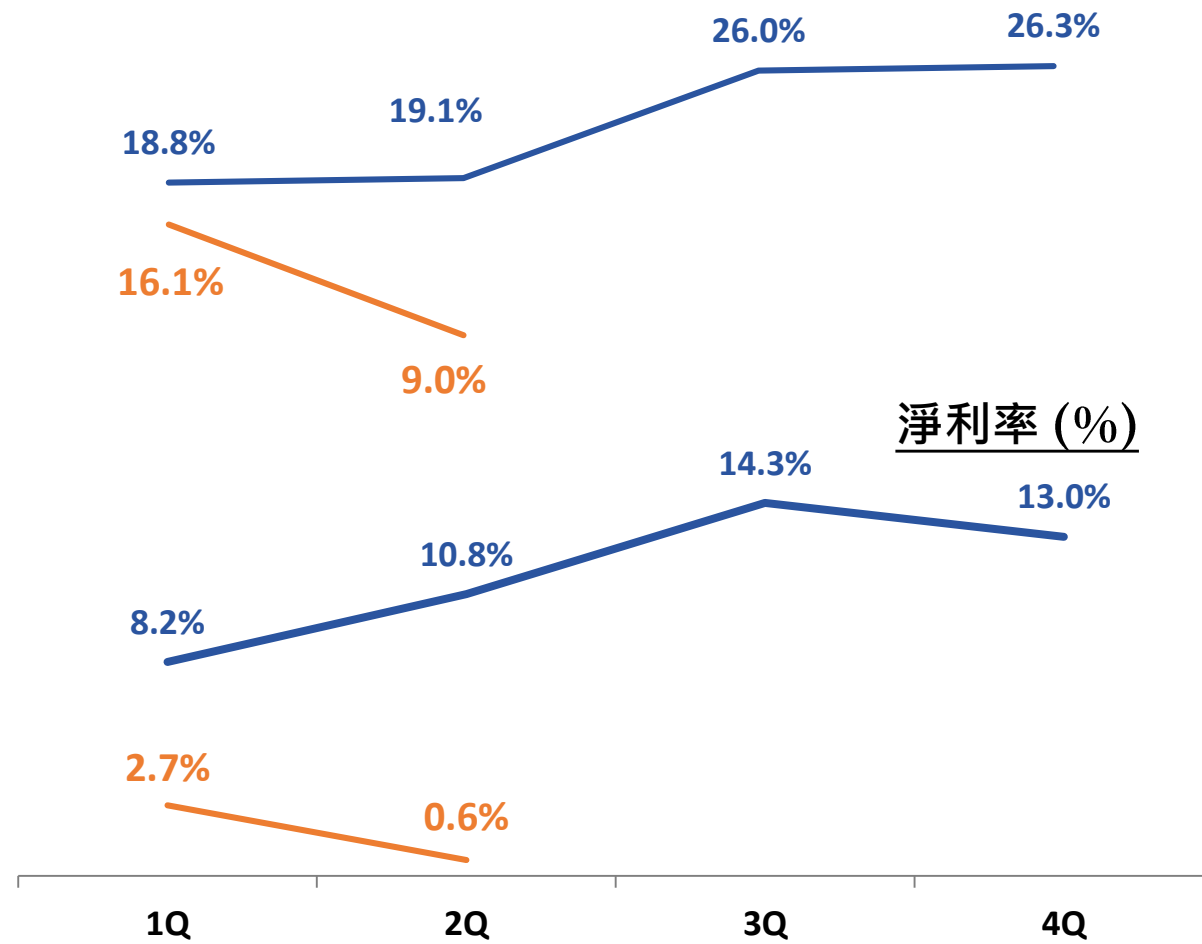
## 營業收入

■ 2022    ■ 2023    單位：新台幣佰萬元



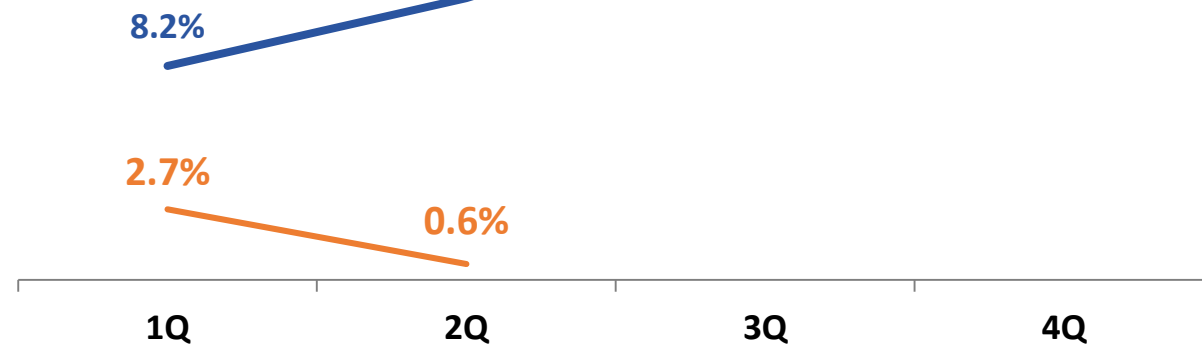
## 毛利率 (%)

— 2022    — 2023

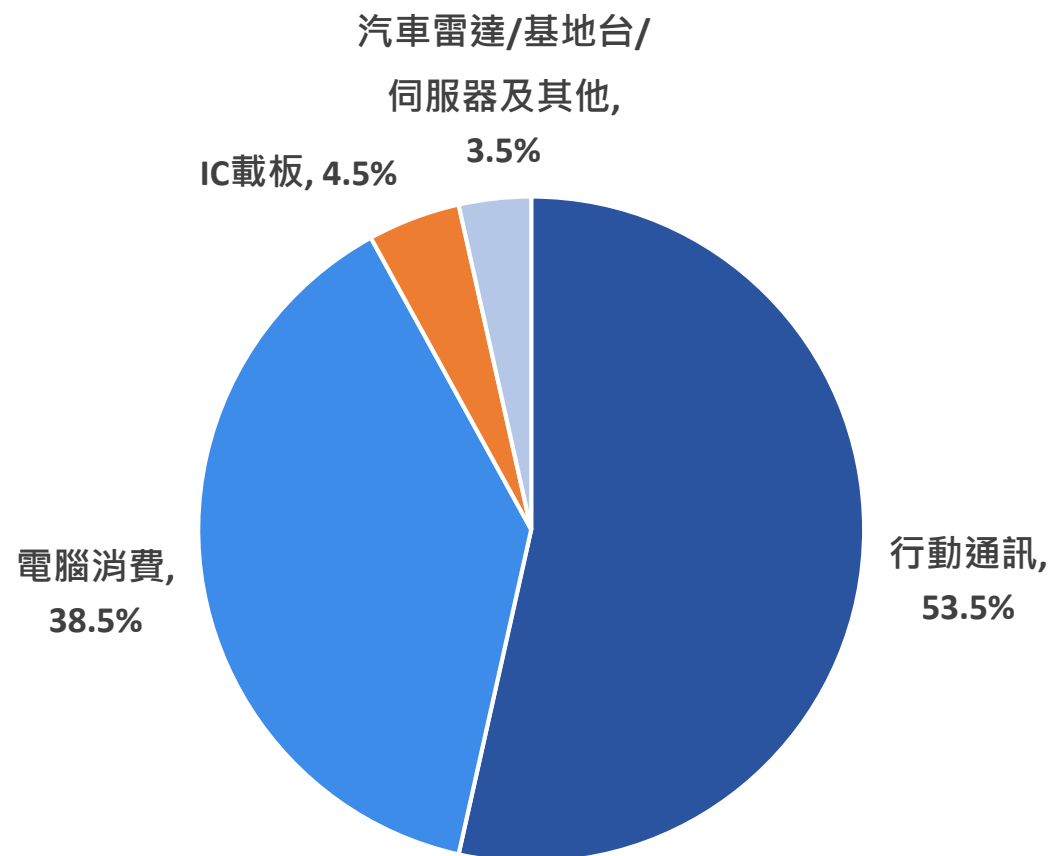


## 淨利率 (%)

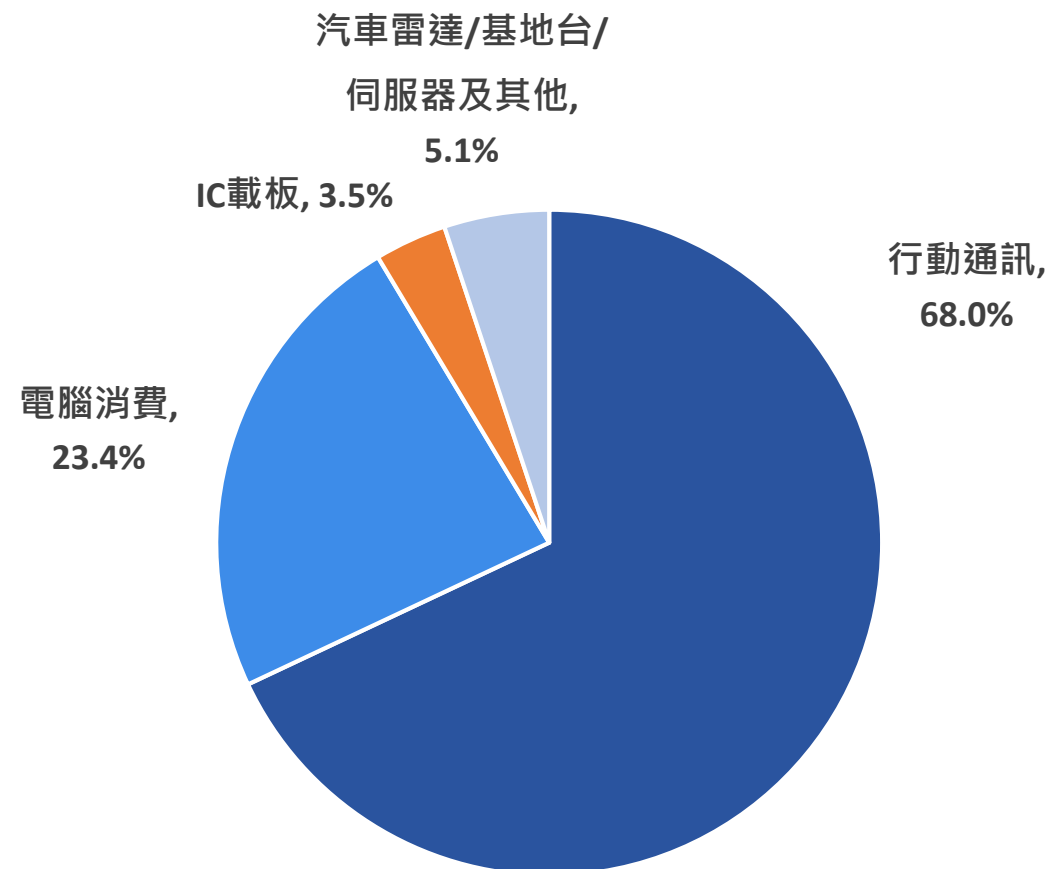
— 2022    — 2023



## 1H2022 營收新台幣685億



## 1H2023 營收新台幣551億





# 資產負債表及重要財務比率

	2023-6-30		2022-6-30		單位：新台幣佰萬元 差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金 <sup>(2)</sup>	59,916	26.8%	44,480	21.5%	15,436	+5.3ppts
應收款項	17,496	7.5%	24,951	12.1%	(7,455)	-4.6ppts
存貨	13,784	5.9%	20,941	10.1%	(7,157)	-4.2ppts
不動產、廠房及設備 <sup>(3)</sup>	108,559	48.5%	96,597	46.7%	11,962	+1.8ppts
<b>資產總額</b>	<b>223,833</b>	<b>100.0%</b>	<b>206,793</b>	<b>100.0%</b>	<b>17,040</b>	
借款	47,455	21.2%	39,019	18.9%	8,436	+2.3ppts
應付款項	35,325	15.8%	37,136	18.0%	(1,811)	-2.2ppts
<b>負債總額</b>	<b>98,219</b>	<b>43.9%</b>	<b>88,242</b>	<b>42.7%</b>	<b>9,977</b>	
<b>股東權益總額</b>	<b>125,615</b>	<b>56.1%</b>	<b>118,551</b>	<b>57.3%</b>		
<b>重要財務比率</b>						
平均收現日數(天)	78		83		(5)	
平均銷貨日數(天)	66		67		(1)	
流動比率(倍)	1.30		1.43		(0.13)	
資產生產力(倍) <sup>(4)</sup>	1.03		1.50		(0.47)	

附註：(1) 2023年6月30日流通在外股數為944,956仟股。(2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。

(3) 不動產、廠房及設備包含投資性不動產。(4) 資產生產力=年化營業收入淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

單位：新台幣佰萬元

年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
營業收入	44,280	55,369	64,483	75,954	85,738	82,393	109,238	117,913	120,068	131,279	155,022	171,356
營業毛利	6,993	10,775	11,894	14,323	16,427	12,542	17,833	26,061	27,222	26,584	30,537	39,888
本期淨利	2,356	4,056	5,471	6,735	7,731	3,456	6,772	11,536	12,402	11,508	13,694	20,535
母公司淨利	2,356	4,056	5,471	6,735	7,731	3,456	5,172	8,448	8,685	8,095	9,651	14,197
折舊及攤銷	3,008	3,375	3,742	4,293	4,850	5,295	5,679	6,820	7,955	8,405	11,875	14,638
每股盈餘 (元)	3.30	5.49	7.41	9.12	9.80	4.29	6.43	10.50	9.93	8.90	10.21	15.02
每股股利 (元)	1.50	2.50	3.00	3.67	4.50	2.20	3.30	4.46	4.50	4.50	5.00	6.00
分派比率 (%)	45.5%	45.5%	40.5%	40.2%	45.9%	51.3%	51.3%	42.5%	45.3%	50.6%	49.0%	40.0%
現金及約當現金 *	4,084	8,756	10,016	23,482	31,572	30,241	33,296	49,154	43,071	46,775	35,179	57,599
不動產、廠房及設備	27,097	26,637	27,843	30,073	32,074	32,262	36,681	41,913	46,243	68,177	86,073	104,814
資本額	6,699	7,034	7,386	7,386	8,047	8,047	8,047	8,047	9,022	9,470	9,470	9,470
股東權益報酬率 (%)	15.34%	21.27%	23.77%	23.33%	20.82%	8.59%	14.49%	17.30%	14.72%	11.84%	12.59%	16.67%
負債比率 (%)	67.03%	66.28%	64.06%	62.54%	53.70%	59.72%	55.33%	44.25%	35.41%	42.56%	42.01%	42.87%

\* 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

# Q&A

---



THANK YOU